プラズマ洗浄装置（プラズマクリーナー）
Plasma Cleaning System (Plasma Cleaner)

日立ハイテク
HITACHI

SPC-100

本装置はワイヤボンディングにおける接合強度の向上、フリップチップボンディングにおける接合強度の向上、またアンダーフィルの充填性向上や樹脂封止の密着性の向上を目的としたプラズマ洗浄装置です。

This plasma cleaning system improves the bonding strength for wire bonding, the bonding strength for flip chip bonding, the filing capability for underfiling and the adhesiveness for resin sealing.

■ ビルドブロック方式により手動式が全自動に変身

◆ 手動式プラズマ洗浄機：SPC-100B（実験研究、小ロット生産向け）

◆ 基板自動搬送装置（マガジン方式）：SPC-100H

＊ SPC-100B導入後、後付けでSPC-100Hをドッキングできます。

□ **The building block concept makes it possible to change SPC-100B from manual to automatic system by the retrofitting of SPC-100H.**

◇ Manual Plasma Cleaner : SPC-100B (For experimental research and small volume production)

◇ Automatic Board Transfer System (Magazine-system) : SPC-100H

＊ After SPC-100B is installed, SPC-100H can be retrofitted

ドッキング可能
Retrofitting

SPC-100B（手動式プラズマ洗浄装置）
SPC-100B (Manual Plasma Cleaner)

SPC-100H（基板自動 搬送装置）
SPC-100H (Automatic board transfer system)

特　長

サイクルタイム：12～30秒／基板

高密度・大面積処理

・高周波電源Max600w、□300mmの処理エリア

ウェーハレベルパッケージ工程でのプラズマ処理

・8インチウェーハリングでの直接処理（オプション）

多品種少量生産～大量生産

・一度に2～3種類の基板を自動で生産可能
・W75mm以下の基板であれば3枚同時処理可能
　さらに、L120mm以下の基板であれば6枚同時処理も可能（オプション）

PE⇔RIEのプラズマプログラム切替が可能（オプション）

Features

Processing time：12～30 sec./board

High Density and Large Area Processing

・RF power source Max600w,Processing Area of □300mm

Plasma Processing in Wafer Level Package Process

・Direct Processing Possible for 8-inch Wafer (option)

Multi-product Small-Scale Production to Mass Production

・Two or three kinds of P.C.B.'s can be processed automatically
・When the P.C.B is W75mm or less, three pieces of P.C.B.'s can be processed at the same time.
・When the P.C.B is L120mm or less, six pieces of P.C.B.'s can be processed at the same time (option)

Programmable switching of PE and RIE is possible (option)

◆ 基本仕様　Basic specifications

機　種　名　Model	SPC-100
対象基板寸法 Substrate dimensions	最大130×300mm、8インチウェーハリング（オプション） Max.130×300mm, 8-inch Wafer (option)
電極構造 Electrode	平行平板電極　PE⇔RIE手動切替 Parallel planer PE⇔RIE switch
高周波電源 RF Power supply	13.56Mhz Max600W RFオートマッチング 13.56Mhz Max.600W RF auto matching
排気系 Exhaust system	ロータリーポンプ　800l/min Rotary pump 800l / min
ガス導入系 Process gas	マスフローコントローラー Ar、O_2（追加オプション：H_2） Mass flow controller Ar, O_2 (additional option : H_2)
装置寸法（W×D×H） SPC-100B SPC-100H External dimensions (W×D×H) SPC-100B SPC-100H	 700×750×1,380mm (タワー灯、モニター部除く) 1,200×580×1,300mm (基板供給ユニット除く) 700×750×1,380mm (excluding the light tower and monitor) 1,200×580×1,300mm (excluding the P.C.B. input unit)

安全に関するご注意

ご使用の前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ正しくご使用ください。

Safety Notes

Read the operating Manual carefully before using the machine.

発売元
株式会社 日立ハイテクノロジーズ
産業システム部
本社　〒105-8717 東京都港区西新橋一丁目24番14号
　　電話　ダイヤルイン(03)3504-5909. 6183
支店　関西支店 大阪(06)4807-2528
　　中部支店 豊田(0565)28-5191
URL http://www.hitachi-hitec.com/products/

製造元
株式会社 日立ハイテクインスツルメンツ
本社　〒370-0596 群馬県邑楽郡大泉町坂田1-1-1
　　電話　(0276)61-7930　FAX　(0276)61-8710
URL http://www.hitachi-hitec-hti.com

Sales
Hitachi High-Technologies Corporation
Industrial and Production System Dept.
24-14,Nishi-Shimbashi 1-chome,Minato-ku,Tokyo 105-8717,Japan
TEL +81-3-3504-6183
URL http://www.hitachi-hitec.com/oversea/

Manufacturer
Hitachi High-Tech Instruments Co., Ltd.
1-1-1 Sakata,Oizumi-Machi,Ora-Gun,Gunma 370-0596,Japan
TEL +81-276-61-7930 FAX +81-276-61-8710
URL http://www.hitachi-hitec-hti.com

●仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがありますのでご了承願います。
●Specifications and any aspects of the machine's appearance are subject to change without prior notice.

再生紙を使用しています。　This brochure was printed on recycled paper.

Printed in Japan April, 2003